

杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C82 版)



资料来源:WSTS,2020.06

受益于国家产业政策对新兴产业的大力支持和对传统行业的升级改造,我国半导体分立器件行业的市场规模稳步增长,销售收入占全球比重逐年上升。根据中国半导体行业协会统计,2018年我国半导体分立器件(该分类还包含光电器件、传感器)的销售收入为 2,716 亿元,同比增长 9.79%。



数据来源:中国半导体行业协会,2019.08。中国半导体行业协会对“半导体分立器件”的定义范围较广,上图半导体分立器件的数据统计范围涵盖了除集成电路以外的所有部分,包括国际上通常定义的分立器件、光电器件、传感器。

(4)公司在半导体分立器件市场的竞争地位发生重大不利变化
我国半导体分立器件行业起步较晚,主要通过国外引进及国内企业自主创新,逐步提升行业的国产化程度,满足日益增长的下游需求。虽然在国内企业的不断努力下,我国半导体分立器件制造行业取得了很大的发展,但在高端半导体分立器件芯片的设计和制造方面,目前与全球领先水平尚存在差距。

目前,国内半导体分立器件业务的市场竞争较为充分,半导体分立器件企业大致可分为三个梯队,具体构成情况及特征如下:

梯队	市场地位	构成企业	特征
第一梯队	国际大型半导体公司,如意法半导体公司、恩智浦半导体公司等		在中国市场较强的竞争优势
第二梯队	少数突破半导体分立器件芯片技术瓶颈的国内企业,如士兰微、华微电子、立昂微电子、扬杰科技等		研发设计制造能力较强,品牌知名度较高,利润空间较高
第三梯队	大量的半导体分立器件封装企业		缺乏芯片设计制造能力,利润空间低,竞争激烈

经过多年发展,公司已拥有完整的肖特基二极管芯片生产线,产品以中高端肖特基二极管芯片为主,在生产技术、产品质量、成本控制等方面具有较强竞争优势,长期以来公司一直是 ONSEMI 的合作伙伴,公司的肖特基二极管芯片产品广泛应用于各类电源管理领域。近年来,公司积极进行产业链的延伸和新产品、新技术的研发工作,2013 年,公司成功收购了三洋半导体 5 英寸 MOSFET 芯片生产线及工艺技术;2015 年,公司收购浙江金瑞泓后横滨半导体分立器件和半导体硅片两大细分行业,成为国内颇具竞争力的半导体产业平台之一;2016 年,公司顺利通过了国际一流汽车芯片巨头博世(Bosch)和大陆集团(Continental)的体系认证,成为国内少数获得车载前装开发资格认证的肖特基二极管芯片供应商;2017 年,公司以委外加工模式开展产品性能验证并至半导体分立器件成品,从而实现对半导体分立器件生产流程的完整布局。

根据中国半导体行业协会的统计,公司在 2017 年中国半导体分立器件十强企业评选中位列第八名。作为国内重要的分立器件生产厂商,公司在国内半导体分立器件行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力,具备一定的竞争优势。

3.公司主要指标情况及 2019 年经营业绩变动原因

公司 2019 年与 2018 年利润表主要指标情况如下:

项目	2019年度	2018年度	同比增幅
营业收入	119,168.60	122,266.70	-2.53%
营业毛利	44,466.26	46,082.87	-3.51%
减:销售费用	1,025.08	1,107.10	-7.41%
管理费用	5,162.60	5,218.18	-1.07%
研发费用	9,699.32	8,661.32	11.98%
财务费用	8,992.84	5,997.03	49.95%
资产减值损失	4,612.79	3,278.80	40.69%
信用减值损失	548.89	-	-
其他收益	4,517.19	3,286.30	37.46%
营业利润	17,389.22	23,648.31	-26.46%
减:所得税费用	2,474.40	2,801.31	-11.67%
净利润	15,120.33	20,892.02	-27.65%
归属于母公司所有者的净利润	12,818.79	18,075.98	-29.08%
归属于母公司股东的非经常性损益净额	4,239.41	2,541.78	66.79%
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	8,579.38	15,534.20	-44.77%

公司 2019 年度业绩下降的主要原因系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加,具体如下:

2019 年,发行人研发费用较 2018 年增加 1,038.01 万元,研发费用率上升至 8.14%,研发费用的增加主要来自于子公司立昂芯和衢州金瑞泓陆续投产对于第二代半导体射频芯片和 8 英寸硅片等产品的研发升级。

2019 年,发行人财务费用较 2018 年增加 2,995.81 万元,财务费用率上升至 7.55%,财务费用的增加主要是由于发行人增加了短期借款,长期借款,售后回租借款等以及应付票据增加所致。第一,第二代半导体射频芯片项目在内的长期资产投资支出导致资金需求以及上述项目投产对于流动资金的需求,因此利息支出总额增加明显。截至 2019 年末,发行人银行借款余额为 170,169.17 万元,较 2018 年末银行借款余额 97,883.87 万元上升 73.85%。

2019 年,发行人资产减值损失和信用减值损失较 2018 年增加 1,882.87 万元,同比增加达 57.43%,其中计提存货跌价损失 2,051.62 万元。发行人子公司立昂芯年产 12 片 6 英寸第二代半导体射频集成电路芯片项目一期生产线上于 2019 年验收转固,已进入客户样品认证试产,量产前的准备阶段,由于当年度整体销量较低原因导致期末存货单位成本高于售价,因此对于半导体射频芯片相关的存货计提存货跌价损失增加 1,295.51 万元。另外,由于本年度 MOSFET 芯片毛利率依然为负,年末对于 MOSFET 芯片相关的存货计提存货跌价损失增加 777.89 万元。

综上所述,发行人 2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

(二)研发费用
报告期内,研发费用持续上升,主要是由于随着子公司立昂芯和衢州金瑞泓的陆续建设及投产,对于包括第二代半导体射频芯片和 8 英寸硅片等新产品所进行的持续研发。在可预见的未来,随着 8 英寸硅片生产工艺的不断完善,预计公司 8 英寸硅片的相关研发投入会有所降低,但随着子公司金瑞泓微电子投产的 12 英寸硅片项目的持续推进,预计公司会加大对 12 英寸硅片的相关研发投入,而对于第二代半导体射频芯片的相关研发投入将会继续保持现有规模。

综上,在未来可预见的时间内,发行人的研发投入将基本维持 2019 年的水平。

2.财务费用
公司财务费用主要为利息支出,报告期内,公司的财务费用持续上升,主要系为应对包括 8 英寸硅片项目、第二代半导体射频芯片项目在内的长期资产投资增加导致的资金需求上升,使得利息支出总额增加明显。在未来可预见的时间内,除上述重大的长期资产投资项目外,公司无其他新增的重大长期资产投资项目。

综上,在未来可预见的时间内,发行人的财务费用将维持 2019 年的水平。

3.资产减值损失和信用减值损失
2019 年,发行人的存货跌价准备计提较多,导致当年度的资产减值损失金额较大,从而对发行人 2019 年的经营业绩产生了一定的负面影响。2019 年发行人计提的存货跌价准备较 2018 年增幅较大,主要系公司对毛利产品(半导体射频芯片及 MOSFET 芯片)相关的原材料及库存商品计提的跌价准备金额增加所致。

2019 年下半年开始,公司毛利产品(半导体射频芯片及 MOSFET 芯片)的订单数量已明显增加,在未来可预见的时间内,上述产品的毛利产品能够上升,存货毛利产品导致的存货跌价情况预计能够得到明显改善。

综上所述,在未来可预见的时间内,发行人的研发投入和财务费用将维持 2019 年的水平,同时毛利产品导致的存货跌价情况预计能够得到明显改善。

(三)发行人 2019 年业绩下滑的主要原因对发行人未来持续经营的影响分析

发行人的持续经营能力除了与研发投入、财务费用和减值损失相关外,还与其外部经营环境和行业竞争地位持续对持续经营能力的影响分析

(1)发行人所处行业情况
发行人处于半导体分立器件和半导体分立器件行业两个半导体行业的细分行业。

就半导体硅片行业来说,根据 SEMI 统计,全球半导体硅片市场规模在 2018 年大幅增长至 113.8 亿美元后出现小幅回调,2019 年为 111.5 亿美元,预期 2020 年将达到 114.6 亿美元;我国半导体硅片市场规模自 2012 年以来呈稳定上升趋势,根据 IC MIA 统计的我国半导体制造材料市场增长率数据,至 2019 年硅片和硅基材料市场规模为 210.8 亿元,2020 年 2019 年的复合增长率为 12.75%。总体上看,发行人所处的半导体硅片行业在未来几年仍将保持稳定增长态势。

就半导体分立器件行业来说,根据 WSTS 统计,2018 年全球半导体分立器件销售额达 241.02 亿美元,同比增长 11.3%;2019 年为 238.81 亿美元,同比下降 0.92%。根据 WSTS 预测,全球半导体分立器件市场规模将在 2020 年至 2021 年基本保持稳定;受益于国家产业政策对新兴产业的大力支持和对传统行业的升级改造,我国半导体分立器件行业的市场规模稳步增长,销售收入占全球比重逐年上升,根据中国半导体行业协会统计,2018 年我国半导体分立器件(该分类还包含光电器件、传感器)的销售收入为 2,716 亿元,同比增长 9.79%。总体上看,发行人所处的半导体分立器件行业在未来几年仍将保持稳定增长的态势。

(2)发行人自身行业地位情况
根据中国半导体行业协会的统计,报告期内发行人子公司浙江金瑞泓在 2015 年至 2017 年中国半导体材料十强企业评选中位列第一,作为国内主要的半导体硅片生产厂商之一,发行人在国内半导体硅片行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力,具备一定的竞争优势。

根据中国半导体行业协会的统计,发行人在 2017 年中国半导体功率器件十强企业评选中位列第八名。作为国内重要的分立器件生产厂商,发行人在国内半导体分立器件行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力,具备一定的竞争优势。

综上,在可预见的未来几年,发行人的自身行业地位不会发生重大的不利变化。

综上所述,发行人的外部经营环境和行业竞争地位未发生重大不利变化

化。

2.发行人的收入规模和综合毛利率水平对持续经营能力的影响分析
(1)收入规模趋势
报告期内,发行人的营业收入分别为 93,201.96 万元、122,266.70 万元和 119,168.60 万元,2020 年上半年经审阅的收入为 64,852.06 万元,占 2019 年全年的 54.42%,在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人能持续保持目前的收入规模。

(2)综合毛利率水平
报告期内,发行人的综合毛利率分别为 29.98%、37.69%和 37.31%,2020 年上半年经审阅的综合毛利率为 36.61%,相比 2019 年略有下降,但仍维持在较高的水平。

鉴于发行人已具备一定的生产规模,营业成本相对稳定,故发行人产品的销售价格对毛利率的影响不大。2019 年,发行人的主营业务毛利率为 37.46%,其中半导体硅片的毛利率贡献(销售比重*毛利率)为 30.58%,对发行人综合毛利率的影响达到 81.63%,2012 年至 2019 年,全球半导体硅片市场的平均价格情况如下:



数据来源:SEMI
由上图可见,2017 年起,全球半导体硅片市场明显回暖,产品需求量持续上升,第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段,半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产,都需要大量的技术人员对生产各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点,半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能,通常要经历一个相对较长的产能爬坡期。在生产建设及产能爬坡的前期,公司大量的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足,从而导致发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%一致,且在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下,预计发行人的综合毛利率能维持预期水平。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业,尤其是半导体硅片,企业需要形成规模化、商业化的生产,需要进行金额巨大的固定资产投资。同时,大规模的资金投入后,生产线从设备购置及整体建设、设备工艺调试,到产品下降验证,再到大规模量产